

THERMOCHIP

FICHA TÉCNICA RESUMEN

THERMOCHIP® PANEL TAH 10/XPS/19 FRISO DE ABETO

FORMATO: 3,00 X 0,55 m. MH



PROPIEDADES DEL PANEL THERMOCHIP

TIPO DE PANEL	e total (mm)	RT (m2K/W)	U (W/m2K)	Peso (kg/m2)	Peso (kg/panel)	*3 apoyos L=1500	
						Carga max. (kg/m2)	Carga a L=200 (kg/m2)
TAHf/10-40-19_XPS 40mm	69,00	1,42	0,70	17,28	28,51	881,00	212,00
TAHf/10-50-19_XPS 50mm	79,00	1,73	0,58	17,60	29,04	1008,00	242,00
TAHf/10-60-19_XPS 60mm	89,00	1,93	0,52	17,92	29,57	1180,00	284,00
TAHf/10-80-19_XPS 80mm	109,00	2,50	0,40	18,56	30,62	1404,00	337,00
TAHf/10-100-19_XPS 100mm	129,00	2,92	0,34	19,20	31,68	1667,00	401,00
TAHf/10-120-19_XPS 120mm	149,00	3,64	0,27	19,84	32,74	1803,00	433,00
TAHf/10-140-19_XPS 140mm	169,00	4,21	0,24	20,48	33,79	1940,00	467,00
TAHf/10-160-19_XPS 160mm	189,00	4,78	0,21	21,12	34,85	>1940,00	>467,00
TAHf/10-200-19_XPS 200mm	229,00	5,62	0,18	22,40	36,96	>1940,00	>467,00

*Resistencia mecánica, cargas positivas en apoyos. L en mm

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

Tablero exterior - Aglomerado hidrófugo

Espesor	e (mm)	19
Conductividad térmica	λD (W/(m·K))	0,13
Densidad	D (kg/m3)	600
Difusión al vapor de agua	μ	20
Calor específico	Ce [J/(kg·K)]	1700

Núcleo aislante - XPS

Espesor	e (mm)	40	50	60	80	100	120	140	160	200
Conductividad térmica	λD (W/(m·K))	0,033	0,033	0,035	0,035	0,037	0,035	0,035	0,035	0,037
Densidad	D (kg/m3)	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Difusión al vapor de agua	μ	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Calor específico	Ce [J/(kg·K)]	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450

Tablero interior - Friso de Abeto

Espesor	e (mm)	10
Conductividad térmica	λD (W/(m·K))	0,15
Densidad	D (kg/m3)	460
Difusión al vapor de agua	μ	20
Calor específico	Ce [J/(kg·K)]	1600